С.С. Гетохин, В.Б. Залесский, М.В. Комар, А.А. Шаметько

ИССЛЕДОВАНИЕ ШУМОВ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МРИ - СТРУКТУР

Технические характеристики систем связи, локации,контроля и обработки виформации во многом определяются используемыми в них оптоэлектронными приборами. Фотоприемники для этих систем должны облядать минимальными собственными шумами, высоким коэффицисатом внутреннего усиления и быстродействием. Традиционно для этих целей используются ФЭУ и лавижные фотодноды. Однако они имеют рид ведостатков, ограничивающих их применсиие. Одним из перспективных приемников оптического излучения, сочетающих достаточную нороговую чувствительность,высокий колффициент внутреннего усиления фототока, визкие требования к стабилизации питающих напряжекий и возможность интеглании для ностьжния многоэлементных приемных систем, является лавинный фотоприемник на основе структур металя-резистивный слой- полупроводник (МРП) [1.2]. Срявнительно весложная технология их производства основана на нонно-плязменном осяждении резистивного слоя SiC на поверхность кремниевой подложки с проводничестью р- типа. На слой SiC путем термического испарения Ni в вакууме наносится полупрозрачный для света электрод.Омический контакт к образну выполняется напылением слоя АІ на обратную сторону креминевой подложки. Для повышения эффективности давинного умножения в МРП-структуре создается множество небольших по размерам р-и-исреходов, включенных нараллельно (рис.1). Стабильвость характеристик такой структуры определяется свойствами резистивного слоя : величиной сквозной проводимости - и соотношением между электровной и дырочной компоневтами полного тока в слое SIC.Благодаря значительной проводимости резистненого слоя МРПструктура работяет в отличие от лавниных МДП-структур при постовином питьющем напряжения. Однако этот слой нозволяет, тем не менее, осуществлять и в МРП-структуре самостябилизированный лавинвый процесс за счет отридательной обратной связи, возникающей из-за увеличения надения напряжения на исм с ростом протекающего через прибор тока и свижения тем самым коэффициента лаванного умножения [3], как показано на рис.2. В данной работе приведены результаты экспериментального исследования спектральной плотности собственных шумов и амилитулного распределения шумовых импульсов фоточувствительных завивных МРП-структур. Приборы, изготовленные в институте электровным АНБ по описанной технологии, имели фоточувствительную плоцадку размером 1мм и 20мм.

- 209 -



Рис.1.Геометрия структуры ме-. талл - резистивный слой - полупроводник



Рис. 2.Зависимость коэффициента умножения и полного тока от величины инициирующего тока.

Измерения спектральвой плотности шумов проводились при напряжениях смещения, соответствующих предпробойному состоянию структур и состоянию пробок. Рабочие точки определяли по вольт-ампериым характеристикам, показанным ва рис. 3 и 4.



Рис.3.Вольт-ампериая характеристика МРП-структуры с фоточувствительной площадкой 1мм²

Рис.4.Вольт-амперная характеристика МРП-струкгуры с фоточувствительной площадкой 20мм²

- 210 -

Измерения проводили в частотном диапазоне от 10 Гц до 30 Мгц, который перекрывался анализатором спектров типа СК4 - 56 и селек-В6 - 10. Полученные типичаые спектральные тивным вольтметром плотности шума исследованных МРП - структур приведены на рис.5 и 6.



20mm² (U=45B)

Полученные результаты выявили у всех именшихся в распоряжении приборов хирактерное увеличение спектральной плотности шума на частотах порядка 100 кГц, что можно объяснить особенностями возвикновения микроплязм в докальных р-в-переходах. Средняя частота их возвикновения, по давным авторов работы [4] должна соответствовать застотному дианазону в несколько десятков килогерц.

Для выяснения характера шумов МРП - структур с помощью многоканального амплитудного анализятора АИ - 1024 исследовались амплитудные распределення шумовых импульсов с экспозицией 6.4 с по "живому" времени в диапазоне температур от +20° С до - 80° С. Полученные данные, излюстрируемые рис. 7, показывают, что с пониженисм температуры уменьшается количество импульсов малой амплитуды при росте числа отсчетов в старших каналах и слябом изменении их общей скорости счетя. Очевидно, что для исследуемых образцов шумы термоэмиссионной природы дают в спектр лишь незначительный вклад, я доминируют слабо зависящие от температуры шумы давинного умножения.

- 2II -



Рис.7. Амплитудные распределения шумов МРП- структур с фоточувствительной площадкой 20мм¹ (изприна канала 64мкВ)

Полученные данные позволяют оценить возможность использования фоточувствительных полупроводниковых МРП - структур с лавинным умножением посителей тока для задач ядеркой спектрометрии. Рассмотрим сцинтилляционный детектор на их основе с кристаллом типа Cal(Tl), облучаемый гамма-кваятами Call Tl), облучаемый токо самвание с структуры соответствует длине волны $\lambda = 750$ км. Суммарный заряд, создаваемый при этом в MPII - структуре,

$$Q = (E/F_{to}) \cdot a_i \cdot a_j \cdot e \cdot M,$$

тде: Е - энергия излучаемых источником гаммя-квантов;

Е₆- средния энергия, необходимая для образования одного фотона в сцинтилляторе;

е - заряд электрона;

а, - коэффициент, учитывающий потери энергии в сцинтиляторе;

а₂ - коэффициент, учитывающий весовнадение спектральных характеристык сцинтиллатора и МРП - структуры.

Принив M = 1000, коэффициент $a_1 = 0,7$, а коэффициент $a_2 = 0,2$, получим суммарный заряд, равный Q = 3,3 $\cdot 10^{-13}$ кулова.

При величные собственной емкости МРП - структуры порядка 100 пФ напряжение полезного сигнала составит примерно 3 мВ.Средяяя амплитуда шумовых импульсов МРП - структуры (рис.7) соизмерима с амплитудой полезного сигнала. Поэтому в настоящее время использовавие исследуемых МРП - структур в сцивтилационных детекторах оправдано ливнь при измерении характеристик высокоэнергетических адерных излучений и зараженных частиц.

Литература

 Гисанов А.Г., Головин В.М., Сядыгов З.Я., Юсипов Н.Ю. Лавнацый фотоприемник на основе структур металл - резистивный слой - полупроводник // Писъма в ЖТФ. - 1988. - Т.14, выяз. 8 - С.706 - 709.
Гисанов А.Г., Головин В.М., Садыгов З.Я., Юсипов Н.Ю. Фотоприемяник с внутренним усилением на основе структур креманй - карбид кремник - металл// Микроэлсктроника. - 1989. - Т.18, вып.1, С.88 - 90.
Гасанов А.Г., Головин В.М., Летягин В.Г., Садыгов З.Я., Юсииов Н.Ю. Особениясти усиления фототока в давикных МРП - структурах// Преприят ИЯИ АН СССР, П - 0673. - М., 1990. - 23с.
Грехов И.В., Сережкив Ю.Н. Лавияный пробой р - в -перехода в поаупроводниках. - Л.: Эмергия, 1980. - 145с.